

高频模块封装 捷研芯有限公司 安徽封装

产品名称	高频模块封装 捷研芯有限公司 安徽封装
公司名称	苏州捷研芯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路2号东景工业坊56幢
联系电话	13915543356

产品详情

μ Module 解决方案把分立式电源、信号链路和隔离式设计中常用的主要组件集成在一个外形类似 IC 的紧凑型封装中。该 μ Module 产品需要经得起严格的测试和高可靠性工艺验证，集成功放模块封装，从而将简化客户产品设计的设计流程和布局。

μ Module 系列产品可适合众多的应用，包括负载点稳压器、电池充电器、LED 驱动器、电源系统管理 (PMBus 数字式管理电源)、隔离式转换器、隔离式收发器和信号链路接收器解决方案。该系列的每款器件均需要专业的应用设计专门知识和实际的品质管控与制造经验，以提供高集成度、易用性以及可重复和有保证的系统性能。

指纹识别封装方案 (LGA+ FPC + Holder)

封装特点：封装结构非常复杂，需要设计软板、硬板、机械机构；进行封装工艺流程选择与优化，考虑各种材料的特性配合选材，优化涂层设计以达到良好指纹识别性能和倩丽外观。

uModule电源管理模块及封装技术

在所有的电子设备和产品中，都不乏电源管理芯片的“身影”。高性能模拟电源管理模块提供了在汽车、电信、工业、医疗、计算、军事以及高端消费类市场中的电源管理和功率转换应用的高效解决方案。

虽然电源管理模块在各行各业内广泛应用，电源模块封装，但是高性能的塑封型uModule电源管理模块国产化率几乎为零，安徽封装，现在基本需要进口，其中最知名的国外公司为凌力尔特 (LINEAR)。

2. SIP集成封装方案优选(Processor + SDRAM)

封装特点：可将两种不同功能的芯片集成封装在一起，实现微型化，高良率和高性能。

方案一：叠层结构SDRAM打线长度太长且与Processor打线有交叉，高频模块封装，影响量产良率。

方案二：我司建议优化方案，可避免线路交叉，信号传输距离更短，提高良率的同时更提高了产品性能

。

高频模块封装-捷研芯有限公司-安徽封装由苏州捷研芯纳米科技有限公司提供。苏州捷研芯纳米科技有限公司（www.jyxsolution.com）是从事“半导体封装,传感器封装,MEMS传感器,智能传感器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理

。